

課題番号 : F-12-WS-0026
支援課題名 (日本語) : 三次元集積デバイスのためのハイブリッド接合技術の検討
Program Title (in English) : Investigation of hybrid bonding for 3D integrated devices
利用者名 (日本語) : 大山 真輝
Username (in English) : Maki Oyama
所属名 (日本語) : 早稲田大学
Affiliation (in English) : Waseda University.

概要 (Summary) :

三次元集積デバイスのチップ基板間の接合をバン
プと樹脂の接合を同時に行うハイブリッド接合にす
ること、プロセス時間の短縮や接合信頼性の向上な
どを目指す。そのために、バンプ作製のための電解め
っきシールド層後のパターンニング製膜について検
討している。

相談の結果、この作製には、リフトオフ・プロセス
を用い、種々の角度で原子が飛来するスパッタ法より
も、発生源が小さい電子ビーム蒸着装置 EBX-6D の方
が適するという結論に至り、これの利用を検討する。

関連特許 (Patent) :

なし。

実験 (Experimental) :

なし。

結果と考察 (Results and Discussion) :

なし。

その他・特記事項 (Others) :

なし。

共同研究者等 (Coauthor) :

なし。

論文・学会発表

(Publication/Presentation) :

なし。